

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代號: 01347)

新聞稿

二零二五年第二季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2025年8月7日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科創板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二五年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二五年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 5.661 億美元，同比增長 18.3%，環比增長 4.6%。
- 毛利率 10.9%，同比上升 0.4 個百分點，環比上升 1.7 個百分點。
- 母公司擁有人應占利潤 800 萬美元，同比上升 19.2%，環比上升 112.1%。

二零二五年第三季度指引

- 我們預計銷售收入約在 6.2 億美元至 6.4 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 10%至 12%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事白鵬博士對二零二五年第二季度業績評論道：

“華虹半導體二零二五年第二季度銷售收入達 5.66 億美元，符合指引預期；毛利率為 10.9%，優於指引。銷售收入和毛利率均實現環比增長，產能利用率亦創下近幾個季度以來的新高。第二季度，在全球貿易及晶圓代工市場呈現一定波動的背景下，公司聚焦自身產品、工藝、研發、供應鏈等核心競爭力的提升，降本增效初見成果，主要營運指標持續改善。”

白總繼續表示：“面對需求分化的半導體市場，公司堅持以特色工藝技術壁壘為錨，力爭在關鍵技術平臺實現技術突破，豐富產品組合。隨著無錫新 12 英寸產線穩步推進產能爬坡，公司將實現產能規模到技術生態的全面升級。市場策略上，公司協同國內外戰略客戶需求，秉持國際化和開放的業務發展戰略，做大做強全球客戶群體。未來公司將繼續積極佈局各項戰略規劃，為提升公司在晶圓代工行業中的優勢地位奠定堅實基礎。”

電話會議公告

日期 2025 年 8 月 7 日，星期四

時間： 17:00 香港/上海時間

05:00 美國東部時間

發言人： 白鵬，總裁兼執行董事

王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 會議將在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/pemdk6h6> 作線上直播

(請提前註冊登記)

電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN (個人身份識別碼)。

<https://register-conf.media-server.com/register/BI1686ec5f75fa43e1a37307d2e98221ed>

重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN (個人身份識別碼)。

網上重播： 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持 “8 英寸 + 12 英寸”、先進 “特色 IC + Power Discrete” 的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有 “8 英寸 + 12 英寸” 先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 另在無錫高新技術產業開發區內建有兩座全球領先的 12 英寸特色工藝晶圓廠, 其中之一是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二五年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	566,065	478,524	540,937	18.3 %	4.6 %
毛利	61,611	50,063	49,997	23.1 %	23.2 %
毛利率	10.9 %	10.5 %	9.2 %	0.4	1.7
經營開支	(97,917)	(90,328)	(97,110)	8.4 %	0.8 %
其他收入/(損失)淨額	10,602	6,885	(8,294)	54.0 %	(227.8)%
稅前損失	(25,704)	(33,380)	(55,407)	(23.0)%	(53.6)%
所得稅(開支)/抵免	(7,097)	(8,368)	3,245	(15.2)%	(318.7)%
期內損失	(32,801)	(41,748)	(52,162)	(21.4)%	(37.1)%
淨利潤率	(5.8)%	(8.7)%	(9.6)%	2.9	3.8
以下各方應佔：					
母公司擁有人	7,952	6,673	3,750	19.2 %	112.1 %
非控股權益	(40,753)	(48,421)	(55,912)	(15.8)%	(27.1)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.005	0.004	0.002	25.0 %	150.0 %
攤薄	0.005	0.004	0.002	25.0 %	150.0 %
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,305	1,106	1,231	18.0 %	6.0 %
產能利用率 ¹	108.3 %	97.9 %	102.7 %	10.4	5.6
淨資產收益率 ²	0.4 %	0.4 %	0.4 %	-	-

二零二五年第二季度

- 銷售收入 5.661 億美元，同比增長 18.3%，環比增長 4.6%，主要得益於付運晶圓數量上升。
- 毛利率 10.9%，同比上升 0.4 個百分點，主要得益於產能利用率提升及平均銷售價格上漲，部分被折舊成本上升所抵消；環比上升 1.7 個百分點，主要得益於產能利用率提升。
- 經營開支 9,790 萬美元，同比上升 8.4%，主要由於研發工程片開支及折舊開支上升；環比上升 0.8%。
- 其他收入淨額 1,060 萬美元，同比上升 54.0%，主要得益於外幣匯兌損失及財務費用下降及政府補貼上升，部分被利息收入下降所抵消；相比上季度其他損失淨額 830 萬美元，主要由於外幣匯兌損失及財務費用下降。
- 所得稅開支 710 萬美元，同比下降 15.2%，主要由於應課稅利潤下降。
- 期內損失 3,280 萬美元，上年同期為 4,170 萬美元，上季度為 5,220 萬美元。
- 母公司擁有人應佔利潤 800 萬美元，同比上升 19.2%，環比上升 112.1%。
- 基本每股盈利 0.005 美元，同比上升 25%，環比上升 150%。
- 淨資產收益率（年化）0.4%，同比及環比均持平。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二五年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第二季度 % (未經審核)	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	541,076	95.6 %	453,345	94.7 %	87,731	19.4 %
其他	24,989	4.4 %	25,179	5.3 %	(190)	(0.8)%
銷售收入總額	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

■ 本季度 95.6%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二五年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第二季度 % (未經審核)	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	232,308	41.0 %	245,471	51.3 %	(13,163)	(5.4)%
12 吋晶圓	333,757	59.0 %	233,053	48.7 %	100,704	43.2 %
銷售收入總額	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

■ 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.323 億美元及 3.338 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二五年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第二季度 % (未經審核)	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	469,674	83.0 %	385,519	80.5 %	84,155	21.8 %
北美 ⁴	53,007	9.4 %	46,829	9.8 %	6,178	13.2 %
亞洲其他 ⁵	28,647	5.0 %	29,003	6.1 %	(356)	(1.2)%
歐洲	14,737	2.6 %	17,173	3.6 %	(2,436)	(14.2)%
銷售收入總額	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.697 億美元，占銷售收入總額的 83.0%，同比增長 21.8%，主要得益於其他電源管理、超級結、模擬及邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於北美的銷售收入 5,300 萬美元，同比增長 13.2%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲其他地區的銷售收入 2,860 萬美元，同比下降 1.2%。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,470 萬美元，同比下降 14.2%，主要由於通用 MOSFET 產品的需求下降。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵自 2025 年第二季度起包括日本。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二五年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第二季度 % (未經審核)	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	141,158	24.9 %	137,126	28.7 %	4,032	2.9 %
獨立式非易失性存儲器	27,603	4.9 %	23,675	4.9 %	3,928	16.6 %
功率器件	166,713	29.5 %	152,371	31.8 %	14,342	9.4 %
邏輯及射頻	68,589	12.1 %	63,487	13.3 %	5,102	8.0 %
模擬與電源管理	161,154	28.5 %	101,137	21.1 %	60,017	59.3 %
其他	848	0.1 %	728	0.2 %	120	16.5 %
銷售收入總額	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.412 億美元，同比增長 2.9%，主要得益於 MCU 產品的需求增加，部分被智能卡芯片的需求下降所抵消。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 2,760 萬美元，同比增長 16.6%，主要得益於閃存產品的需求增加。
- 本季度功率器件銷售收入 1.667 億美元，同比增長 9.4%，主要得益於超級結及通用 MOSFET 產品需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 6,860 萬美元，同比增長 8.0%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.612 億美元，同比增長 59.3%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二五年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第二季度 % (未經審核)	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
65nm 及以下	125,537	22.2 %	98,550	20.6 %	26,987	27.4 %
90nm 及 95nm	145,447	25.7 %	95,285	19.9 %	50,162	52.6 %
0.11μm 及 0.13μm	64,011	11.3 %	68,660	14.3 %	(4,649)	(6.8)%
0.15μm 及 0.18μm	29,059	5.1 %	30,508	6.4 %	(1,449)	(4.7)%
0.25μm	1,174	0.2 %	2,436	0.5 %	(1,262)	(51.8)%
0.35μm 及以上	200,837	35.5 %	183,085	38.3 %	17,752	9.7 %
銷售收入總額	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

- 本季度 65nm 及以下工藝技術節點的銷售收入 1.255 億美元，同比增長 27.4%，主要得益於模擬、邏輯及閃存產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.454 億美元，同比增長 52.6%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.11μm 及 0.13μm 工藝技術節點的銷售收入 6,400 萬美元，同比下降 6.8%，主要由於 MCU 及智能卡芯片產品的需求下降，部分被邏輯產品需求增加所抵消。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 2,910 萬美元，同比下降 4.7%。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 120 萬美元，同比下降 51.8%，主要由於功率器件產品的需求下降。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.008 億美元，同比增長 9.7%，主要得益於超級結、通用 MOSFET 及其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的 銷售收入	二零二五年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第二季度 % (未經審核)	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
消費電子	357,370	63.1 %	298,320	62.4 %	59,050	19.8 %
工業及汽車	129,150	22.8 %	110,643	23.1 %	18,507	16.7 %
通信	71,638	12.7 %	59,486	12.4 %	12,152	20.4 %
計算	7,907	1.4 %	10,075	2.1 %	(2,168)	(21.5)%
銷售收入總額	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

- 本季度消費電子作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.574 億美元，占銷售收入總額的 63.1%，同比增長 19.8%，主要得益於其他電源管理、超級結、邏輯及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.292 億美元，同比增長 16.7%，主要得益於 MCU 及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度通信類產品銷售收入 7,160 萬美元，同比增長 20.4%，主要得益於模擬產品的需求增加。
- 本季度計算類產品銷售收入 790 萬美元，同比下降 21.5%，主要由於 MCU、模擬及邏輯產品的需求下降。

產能⁶及產能利用率

	二零二五年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)
總產能(折合 8 吋仟片晶圓)	447	391	413
總體產能利用率	108.3%	97.9%	102.7%

- 本季度末月產能 447,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 108.3%，較上季度上升 5.6 個百分點。

付運晶圓

折合 8 吋仟片晶圓	二零二五年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,305	1,106	1,231	18.0 %	6.0 %

- 本季度付運晶圓 1,305,000 片，同比上升 18.0%，環比上升 6.0%。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

經營開支分析

以仟美元計	二零二五年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,630	2,785	2,214	(5.6)%	18.8 %
管理費用 ⁷	95,287	87,543	94,896	8.8 %	0.4 %
經營開支	97,917	90,328	97,110	8.4 %	0.8 %

- 經營開支 9,790 萬美元，同比上升 8.4%，主要由於研發工程片開支及折舊開支上升；環比上升 0.8%。

其他收入/(損失)淨額

以仟美元計	二零二五年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,460	3,558	3,513	(2.8)%	(1.5)%
利息收入	15,294	29,787	15,619	(48.7)%	(2.1)%
匯兌損失	(1,064)	(7,921)	(16,199)	(86.6)%	(93.4)%
分佔聯營公司溢利	591	1,394	652	(57.6)%	(9.4)%
財務費用	(18,250)	(24,847)	(23,301)	(26.6)%	(21.7)%
政府補貼	9,866	4,778	11,231	106.5 %	(12.2)%
其他	705	136	191	418.4 %	269.1 %
其他收入/(損失)淨額	10,602	6,885	(8,294)	54.0 %	(227.8)%

- 其他收入淨額 1,060 萬美元，同比上升 54.0%，主要得益於外幣匯兌損失及財務費用下降及政府補貼上升，部分被利息收入下降所抵消；相比上季度其他損失淨額 830 萬美元，主要由於外幣匯兌損失及財務費用下降。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以仟美元計	二零二五年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	169,630	96,890	50,186	75.1 %	238.0 %
投資活動所用現金流量淨額	(385,556)	(171,973)	(494,291)	124.2 %	(22.0)%
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(25,185)	416,148	59,137	(106.1)%	(142.6)%
外匯匯率變動影響淨額	8,076	(25,185)	5,771	(132.1)%	39.9 %
現金及現金等價物變動影響淨額	(233,035)	315,880	(379,197)	(173.8)%	(38.5)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.696 億美元，同比上升 75.1%，環比上升 238.0%，主要得益於客戶收款增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 3.856 億美元，其中包括固定資產投資支出 4.077 億美元，及對聯營企業投資 280 萬美元，部分被利息收入 1,940 萬美元及，收到政府對設備的補助 550 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 2,520 萬美元，其中償還銀行借款 1.257 億美元，支付利息 3,860 萬美元，及支付租賃負債 120 萬美元，部分被提取銀行借款 1.381 億美元，及員工行權發行股份收到 220 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)
資產總額	12,237,080	12,286,786
負債總額	3,363,437	3,406,124
所有者權益總額	8,873,643	8,880,662
資產負債率 ⁸	27.5%	27.7%

資本開支

以仟美元計	二零二五年 第二季度 (未經審核)	二零二五年 第一季度 (未經審核)
華虹 8 吋	17,612	14,264
華虹無錫	13,676	18,402
華虹製造	376,440	478,185
合計	407,728	510,851

- 本季度資本開支 4.077 億美元，其中 3.764 億美元用於華虹製造，1,760 萬美元用於華虹 8 吋，及 1,370 萬美元用於華虹無錫。

⁸資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)
發展中物業	221,661	221,061
存貨	513,434	468,597
貿易應收款項及應收票據	264,329	286,763
預付款項、其他應收款項及其他資產	452,513	411,207
應收關聯方款項	14,360	16,520
已凍結存款及定期存款	31,756	31,669
現金及現金等價物	3,846,900	4,079,935
流動資產總額	5,344,953	5,515,752
貿易應付款項	263,352	255,321
其他應付款項及暫估費用	716,648	759,177
計息銀行借款	341,313	329,972
租賃負債	5,839	7,543
政府補助	59,040	57,700
應付關聯方款項	8,560	12,724
應付所得稅	16,046	18,620
流動負債總額	1,410,798	1,441,057
淨營運資金	3,934,155	4,074,695
速動比率	3.3x	3.3x
流動比率	3.8x	3.8x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	44	46
存貨周轉天數	88	86

- 存貨由上季度末的 4.686 億美元上升至本季度末的 5.134 億美元，主要由於新工廠的在製品及產成品增加。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 4.112 億美元上升至本季度末的 4.525 億美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 7.592 億美元下降至本季度末的 7.166 億美元，主要由於本季度支付應付資本開支。
- 計息銀行借款由上季度末的 3.300 億美元上升至本季度末的 3.413 億美元，主要由於一年內到期的長期銀行借款增加。
- 淨營運資金 本季度末 39.342 億美元，流動比率 3.8。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 44 天。
- 存貨周轉天數 88 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)
銷售收入	566,065	478,524	540,937
銷售成本	(504,454)	(428,461)	(490,940)
毛利	61,611	50,063	49,997
其他收入及收益	29,353	38,259	30,563
銷售及分銷費用	(2,630)	(2,785)	(2,214)
管理費用	(95,287)	(87,543)	(94,896)
其他費用	(1,092)	(7,921)	(16,208)
財務費用	(18,250)	(24,847)	(23,301)
分佔聯營公司溢利	591	1,394	652
稅前損失	(25,704)	(33,380)	(55,407)
所得稅(開支)/抵免	(7,097)	(8,368)	3,245
期內損失	(32,801)	(41,748)	(52,162)
以下各方應佔：			
母公司擁有人	7,952	6,673	3,750
非控股權益	(40,753)	(48,421)	(55,912)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.005	0.004	0.002
攤薄	0.005	0.004	0.002
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,726,241,791	1,716,917,408	1,721,931,435
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,731,895,843	1,720,532,998	1,728,142,630

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	6,101,971	5,967,555	3,750,176
投資物業	218,468	209,257	165,611
使用權資產	66,002	76,359	80,629
無形資產	27,313	29,122	42,320
於聯營公司的投資	144,421	140,650	141,036
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	290,515	289,722	285,938
長期預付款項	42,672	57,989	139,425
遞延稅項資產	765	380	629
非流動資產總額	6,892,127	6,771,034	4,605,764
流動資產			
發展中物業	221,661	221,061	207,151
存貨	513,434	468,597	462,563
貿易應收款項及應收票據	264,329	286,763	274,382
預付款項、其他應收款項及其他資產	452,513	411,207	75,761
應收關聯方款項	14,360	16,520	16,034
已凍結存款及定期存款	31,756	31,669	39,259
現金及現金等價物	3,846,900	4,079,935	6,423,866
流動資產總額	5,344,953	5,515,752	7,499,016
流動負債			
貿易應付款項	263,352	255,321	246,206
其他應付款項及暫估費用	716,648	759,177	505,945
計息銀行借款	341,313	329,972	247,034
租賃負債	5,839	7,543	4,674
政府補助	59,040	57,700	39,359
應付關聯方款項	8,560	12,724	8,340
應付所得稅	16,046	18,620	19,038
流動負債總額	1,410,798	1,441,057	1,070,596
流動資產淨額	3,934,155	4,074,695	6,428,420
總資產減流動負債	10,826,282	10,845,729	11,034,184
非流動負債			
計息銀行借款	1,933,971	1,948,409	1,964,956
租賃負債	15,035	15,160	19,440
遞延稅項負債	3,633	1,498	4,892
非流動負債總額	1,952,639	1,965,067	1,989,288
淨資產	8,873,643	8,880,662	9,044,896
權益和負債權益			
股本	4,960,855	4,957,182	4,935,470
儲備	1,339,047	1,315,995	1,333,799
本公司擁有人應佔權益	6,299,902	6,273,177	6,269,269
非控股權益	2,573,741	2,607,485	2,775,627
權益總額	8,873,643	8,880,662	9,044,896

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)
經營活動現金流量：			
稅前虧損	(25,704)	(33,380)	(55,407)
折舊及攤銷	179,658	136,881	172,126
應佔聯營公司溢利	(591)	(1,394)	(652)
營運資金的變動及其它	16,267	(5,217)	(65,881)
經營活動所得現金流量淨額	169,630	96,890	50,186
投資活動現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(407,728)	(196,830)	(510,851)
投資聯營企業	(2,794)	-	-
其他投資活動所得現金流量	24,966	24,857	16,560
投資活動所用現金流量淨額	(385,556)	(171,973)	(494,291)
融資活動現金流量：			
提取銀行貸款	138,096	99,042	860,985
發行股份所得收益	2,218	579	13,077
償還銀行貸款	(125,677)	(87,530)	(811,156)
已付利息	(38,623)	(49,800)	(3,252)
支付租賃負債	(1,199)	(2,348)	(517)
非控股權益資本注資	-	492,450	-
支付股息	-	(36,245)	-
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(25,185)	416,148	59,137
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(241,111)	341,065	(384,968)
期初現金及現金等價物	4,079,935	6,107,986	4,459,132
外匯匯率變動影響淨額	8,076	(25,185)	5,771
期末現金及現金等價物	3,846,900	6,423,866	4,079,935

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

唐均君(董事長)

白鵬(總裁)

非執行董事

葉峻

孫國棟

陳博

熊承艷

獨立非執行董事

張祖同

王桂壠太平紳士

封松林

承董事会命

華虹半導體有限公司

唐均君

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二五年八月七日